

2018-2022年中国集成电路封装市场调查与发展前景预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2022年中国集成电路封装市场调查与发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yiqiyibiao/378040378040.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

观研天下发布的《2018-2022年中国集成电路封装市场调查与发展前景预测报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第1章：中国集成电路封装行业发展背景 15

1.1 集成电路封装行业定义及分类 15

1.1.1 集成电路封装行业定义 15

1.1.2 集成电路封装行业产品大类 15

1.1.3 集成电路封装行业特性分析 16

(1) 行业周期性 16

(2) 行业区域性 16

(3) 行业季节性 16

1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析 17

1.2 集成电路封装行业政策环境分析 18

1.2.1 行业管理体制 18

- 1.2.2 行业相关政策 18
- 1.3 集成电路封装行业经济环境分析 19
 - 1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析 19
 - (1) 国际宏观经济现状 19
 - (2) 国际宏观经济环境对行业影响分析 22
 - 1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析 22
 - (1) GDP增长情况分析 22
 - (2) 居民收入水平 24
- 1.4 集成电路封装行业技术环境分析 25
 - 1.4.1 集成电路封装技术演进分析 25
 - 1.4.2 集成电路封装形式应用领域 26
 - 1.4.3 集成电路封装工艺流程分析 26
 - 1.4.4 集成电路封装行业新技术动态 27

第2章：中国集成电路产业发展分析 29

2.1 集成电路产业发展状况 29

近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，中国集成电路产业实现了快速发展。报告期内，中国集成电路行业市场增速明显高于全球水平。2013年以来，集成电路行业受国家政策支持力度加大和市场需求形势趋好推动，整体复苏态势强劲，产销增长加快，效益大幅提升，国内产业实力进一步增强，对提高我国电子信息产业核心竞争力进一步发挥积极作用。根据中国半导体行业协会统计，2013年、2014年和2015年，中国集成电路产业销售额分别为2,508.5亿元、3,015.4亿元和3,609.8亿元，2014年和2015年的增长率分别为20.2%和19.7%。受到国内“中国制造2025”、“互联网+”等的带动，以及外资企业加大在华投资影响，2015年中国集成电路产业保持高速增长。

2013-2017年国内集成电路产业销售额及增长率分析（单位：亿元）

2.1.1 集成电路产业链简介 29

集成电路产业链包括设计、制造、封装和测试等环节，各个环节目前已分别发展成为独立、成熟的子行业。按照一般产品购销关系划分的上下游关系，晶圆代工厂商、封装和测试厂商接受集成电路设计企业委托，按照产品方案向集成电路设计企业提供芯片制造、封装和测试服务，集成电路制造、封装和测试行业为集成电路设计行业上游；集成电路设计厂商将芯片产成品销售给电子设备制造厂商，电子设备制造行业为集成电路设计行业下游。

2.1.2 集成电路产业发展现状分析 29

- (1) 行业发展势头良好 29
- (2) 行业技术水平快速提升 30
- (3) 行业竞争力仍有待加强 30
- (4) 产业结构进一步优化 31

2.1.3 集成电路产业区域发展格局分析 31

- (1) 三大区域集聚发展格局业已形成 31
- (2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征 33
- (3) 产业整体将“有聚有分，东进西移” 33

2.1.4 集成电路产业面临的发展机遇 34

- (1) 产业政策环境进一步向好 35
- (2) 战略性新兴产业将加速发展 35
- (3) 资本市场将为企业融资提供更多机会 35

2.1.5 集成电路产业面临的主要问题 35

- (1) 规模小 35
- (2) 创新不足 35
- (3) 价值链整合不够 36
- (4) 产业链不完善 36

2.1.6 集成电路产业“十三五”发展预测 36

2.2 集成电路设计业发展状况 36

受益于市场需求的不断增长、国家产业政策的推动、集成电路设计企业能力的提升，集成电路设计行业整体呈现良好的发展势头。在集成电路设计、制造、封测等细分领域中，集成电路设计行业增速最快。2013年、2014年和2015年，中国集成电路设计产业销售额分别为808.8亿元、1,047.4亿元和1,325亿元，2014年和2017年的增长率分别为29.5%和26.5%。

2013-2017年国内集成电路设计产业销售额及增长率分析（单位：亿元）

2.2.1 集成电路设计业发展概况 36

2.2.2 集成电路设计业发展特征 37

- (1) 产业规模持续扩大 37
- (2) 质量上升数量下降 38
- (3) 企业规模持续扩大 38
- (4) 技术能力大幅提升 38

2.2.3 集成电路设计业发展隐忧	39
2.2.4 集成电路设计业新发展策略	39
2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测	39
2.3 集成电路制造业发展状况	40
2.3.1 集成电路制造业发展现状分析	40
(1) 集成电路制造业发展总体概况	40
(2) 集成电路制造业发展主要特点	40
(3) 集成电路制造业规模及财务指标分析	41
1) 集成电路制造业规模分析	41
2) 集成电路制造业盈利能力分析	41
3) 集成电路制造业运营能力分析	42
4) 集成电路制造业偿债能力分析	42
5) 集成电路制造业发展能力分析	43
2.3.2 集成电路制造业经济指标分析	43
(1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素	43
(2) 集成电路制造业经济指标分析	44
(3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析	45
(4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析	47
(5) 不同地区企业经济指标分析	49
2.3.3 集成电路制造业供需平衡分析	60
(1) 全国集成电路制造业供给情况分析	60
1) 全国集成电路制造业总产值分析	60
2) 全国集成电路制造业产成品分析	61
(2) 全国集成电路制造业需求情况分析	61
1) 全国集成电路制造业销售产值分析	61
2) 全国集成电路制造业销售收入分析	62
(3) 全国集成电路制造业产销率分析	63
2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测	63
第3章：中国集成电路封装行业发展分析	64
3.1 中国集成电路封装行业整体发展情况	64
3.1.1 集成电路封装行业规模分析	64
3.1.2 集成电路封装行业发展现状分析	64
3.1.3 集成电路封装行业利润水平分析	65
3.1.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较	66

3.1.5 集成电路封装行业影响因素分析 66

(1) 有利因素 66

(2) 不利因素 67

3.1.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测 68

(1) 发展趋势分析 68

(2) 前景预测 69

3.2 半导体封测发展情况分析 70

3.2.1 半导体行业发展概况 70

3.2.2 半导体行业景气预测 70

3.2.3 半导体封装发展分析 72

(1) 封装环节产值逐年成长 73

(2) 封装环节外包是未来发展趋势 73

3.3 集成电路封装类专利分析 74

3.3.1 专利分析样本构成 74

(1) 数据库选择 74

(2) 检索方式 74

3.3.2 专利发展情况分析 75

(1) 专利申请数量趋势 75

(2) 专利公开数量趋势 76

(3) 技术类型情况分析 77

(4) 技术分类趋势分布 77

(5) 主要权利人分布情况 78

3.4 集成电路封装过程部分技术问题探讨 79

3.4.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策 79

(1) 封装开裂的影响因素分析 79

(2) 管控影响开裂的因素的方法分析 81

3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策 81

(1) 产生芯片弹坑问题的因素分析 81

(2) 预防芯片弹坑问题产生的方法 82

第4章：中国集成电路封装行业市场需求分析 85

4.1 集成电路市场分析 85

4.1.1 集成电路市场规模 85

4.1.2 集成电路市场结构分析 85

(1) 集成电路市场产品结构分析 85

- (2) 集成电路市场应用结构分析 86
- 4.1.3 集成电路市场竞争格局 87
- 4.1.4 集成电路国内市场自给率 87
- 4.1.5 集成电路市场发展预测 88
- 4.2 集成电路封装行业需求分析 88
 - 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析 88
 - (1) 计算机市场发展现状 88
 - (2) 集成电路在计算机领域的应用 89
 - (3) 计算机领域对行业需求的拉动 89
 - 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析 90
 - (1) 消费电子市场发展现状 90
 - (2) 消费电子领域对行业需求的拉动 93
 - 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析 93
 - (1) 通信设备市场发展现状 93
 - (2) 集成电路在通信设备领域的应用 95
 - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动 96
 - 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析 96
 - (1) 工控设备市场发展现状 97
 - (2) 集成电路在工控设备领域的应用 97
 - (3) 工控设备领域对行业需求的拉动 97
 - 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析 97
 - (1) 汽车电子市场发展现状 97
 - (2) 集成电路在汽车电子领域的应用 99
 - (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动 99
 - 4.2.6 其他应用领域对行业的需求分析 99

第5章：集成电路封装行业市场竞争分析 103

- 5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析 103
 - 5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况 103
 - 5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析 103
 - 5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析 104
 - (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本 104
 - (2) 主板材料的变化趋势 107
 - 5.1.4 跨国企业在华市场竞争力分析 108
 - (1) 台湾日月光集团竞争力分析 108

- 1) 企业发展简介 108
- 2) 企业经营情况分析 108
- 3) 企业主营产品及应用领域 109
- 4) 企业市场区域及行业地位分析 109
- 5) 企业在中国市场投资布局情况 109
- (2) 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析 110
 - 1) 企业发展简介 110
 - 2) 企业经营情况分析 110
 - 3) 企业主营产品及应用领域 110
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析 110
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况 110
- (3) 台湾矽品公司竞争力分析 110
 - 1) 企业发展简介 110
 - 2) 企业经营情况分析 111
 - 3) 企业主营产品及应用领域 111
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析 112
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况 112
- (4) 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析 112
 - 1) 企业发展简介 112
 - 2) 企业经营情况分析 112
 - 3) 企业主营产品及应用领域 112
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析 113
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况 113
- (5) 力成科技股份有限公司竞争力分析 113
 - 1) 企业发展简介 113
 - 2) 企业经营情况分析 113
 - 3) 企业主营产品及应用领域 113
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析 113
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况 114
- (6) 飞思卡尔公司竞争力分析 114
 - 1) 企业发展简介 114
 - 2) 企业经营情况分析 114
 - 3) 企业主营产品及应用领域 114
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析 114
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况 115

- (7) 英飞凌科技公司竞争力分析 115
 - 1) 企业发展简介 115
 - 2) 企业经营情况分析 115
 - 3) 企业主营产品及应用领域 115
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析 115
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况 115
- 5.2 集成电路封装行业国内竞争格局分析 116
 - 5.2.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析 116
 - 5.2.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析 117
- 5.3 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析 117
 - 5.3.1 现有竞争者之间的竞争 117
 - 5.3.2 上游议价能力分析 118
 - 5.3.3 下游议价能力分析 119
 - 5.3.4 行业潜在进入者分析 119
 - 5.3.5 替代品风险分析 120
 - 5.3.6 行业竞争五力模型总结 120
- 第6章：中国集成电路封装行业产品市场分析 122
 - 6.1 集成电路封装行业BGA产品市场分析 122
 - 6.1.1 BGA封装技术 122
 - 6.1.2 BGA产品主要应用领域 123
 - 6.1.3 BGA产品需求拉动因素 124
 - 6.1.4 BGA产品市场应用现状分析 125
 - 6.1.5 BGA产品市场前景展望 125
 - 6.2 集成电路封装行业SIP产品市场分析 126
 - 6.2.1 SIP封装技术 126
 - 6.2.2 SIP产品主要应用领域 126
 - 6.2.3 SIP产品需求拉动因素 127
 - 6.2.4 SIP产品市场应用现状分析 127
 - 6.2.5 SIP产品市场前景展望 128
 - 6.3 集成电路封装行业SOP产品市场分析 129
 - 6.3.1 SOP封装技术 129
 - 6.3.2 SOP产品主要应用领域 130
 - 6.3.3 SOP产品市场发展现状 130
 - 6.3.4 SOP产品市场前景展望 131

- 6.4 集成电路封装行业QFP产品市场分析 131
 - 6.4.1 QFP封装技术 131
 - 6.4.2 QFP产品主要应用领域 132
 - 6.4.3 QFP产品市场发展现状 132
 - 6.4.4 QFP产品市场前景展望 132
- 6.5 集成电路封装行业QFN产品市场分析 132
 - 6.5.1 QFN封装技术 132
 - 6.5.2 QFN产品主要应用领域 133
 - 6.5.3 QFN产品市场发展现状 133
 - 6.5.4 QFN产品市场前景展望 134
- 6.6 集成电路封装行业MCM产品市场分析 134
 - 6.6.1 MCM封装技术水平概况 134
 - (1) 概念简介 134
 - (2) MCM封装分类 134
 - 6.6.2 MCM产品主要应用领域 135
 - 6.6.3 MCM产品需求拉动因素 135
 - 6.6.4 MCM产品市场发展现状 136
 - 6.6.5 MCM产品市场前景展望 136
- 6.7 集成电路封装行业CSP产品市场分析 137
 - 6.7.1 CSP封装技术水平概况 137
 - (1) 概念简介 137
 - (2) CSP产品特点 138
 - (3) CSP封装分类 138
 - 6.7.2 CSP产品主要应用领域 139
 - 6.7.3 CSP产品市场发展现状 139
 - 6.7.4 CSP产品市场前景展望 140
- 6.8 集成电路封装行业其他产品市场分析 140
 - 6.8.1 晶圆级封装市场分析 140
 - (1) 概念简介 140
 - (2) 产品特点 141
 - (3) 主要应用领域 141
 - (4) 市场规模与主要供应商 142
 - (5) 前景展望 142
 - 6.8.2 覆晶/倒封装市场分析 143
 - (1) 概念简介 143

- (2) 产品特点 143
- (3) 市场前景 143
- 6.8.3 3D封装市场分析 143
 - (1) 概念简介 143
 - (2) 封装方法 143
 - (3) 封装特点 144
 - (4) 发展现状与前景 145

- 第7章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析 146
 - 7.1 集成电路封装企业发展总体状况分析 146
 - 7.1.1 集成电路封装行业制造商销售收入排名 146
 - 7.1.2 集成电路封装行业制造商利润总额排名 146
 - 7.2 集成电路封装行业领先企业个案分析 147
 - 7.2.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析 147
 - (1) 企业发展简况分析 147
 - (2) 企业产销能力分析 148
 - (3) 企业盈利能力分析 148
 - (4) 企业运营能力分析 149
 - (5) 企业偿债能力分析 149
 - (6) 企业发展能力分析 150
 - (7) 企业产品结构及新产品动向 150
 - (8) 企业销售渠道与网络 150
 - (9) 企业经营状况优劣势分析 150
 - 7.2.2 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析 151
 - (1) 企业发展简况分析 151
 - (2) 企业产销能力分析 151
 - (3) 企业盈利能力分析 152
 - (4) 企业运营能力分析 152
 - (5) 企业偿债能力分析 153
 - (6) 企业发展能力分析 153
 - (7) 企业产品结构及新产品动向 154
 - (8) 企业销售渠道与网络 154
 - (9) 企业经营状况优劣势分析 154
 - 7.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析 154
 - (1) 企业发展简况分析 154

- (2) 主要经济指标分析 155
- (3) 企业盈利能力分析 156
- (4) 企业运营能力分析 156
- (5) 企业偿债能力分析 157
- (6) 企业发展能力分析 157
- (7) 企业组织架构分析 158
- (8) 企业产品结构及新产品动向 158
- (9) 企业销售渠道与网络 159
- (10) 企业经营状况优劣势分析 160
- (11) 企业投资兼并与重组分析 160
- (12) 企业最新发展动向分析 161
- 7.2.4 上海松下半导体有限公司经营情况分析 161
 - (1) 企业发展简况分析 161
 - (2) 企业产销能力分析 161
 - (3) 企业盈利能力分析 162
 - (4) 企业运营能力分析 162
 - (5) 企业偿债能力分析 163
 - (6) 企业发展能力分析 163
 - (7) 企业产品结构及新产品动向 164
 - (8) 企业销售渠道与网络 164
 - (9) 企业经营状况优劣势分析 164
- 7.2.5 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析 164
 - (1) 企业发展简况分析 164
 - (2) 企业产销能力分析 165
 - (3) 企业盈利能力分析 165
 - (4) 企业运营能力分析 166
 - (5) 企业偿债能力分析 166
 - (6) 企业发展能力分析 167
 - (7) 企业产品结构及新产品动向 167
 - (8) 企业销售渠道与网络 167
 - (9) 企业经营状况优劣势分析 168
-另有23家企业分析

第8章：中国集成电路封装行业投资分析及建议 253

8.1 集成电路封装行业投资特性分析 253

8.1.1 集成电路封装行业进入壁垒	253
(1) 技术壁垒	253
(2) 资金壁垒	253
(3) 人才壁垒	253
(4) 严格的客户认证制度	253
8.1.2 集成电路封装行业盈利模式	254
8.1.3 集成电路封装行业盈利因素	254
8.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析	255
8.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况	255
8.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析	255
8.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析	257
(1) 通富微电公司投资兼并与重组分析	257
(2) 华天科技公司投资兼并与重组分析	258
(3) 长电科技公司投资兼并与重组分析	259
8.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析	260
8.3 集成电路封装行业投融资分析	260
8.3.1 电子发展基金对集成电路产业的扶持分析	260
(1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况	260
(2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议	261
8.3.2 集成电路封装行业融资成本分析	262
8.3.3 半导体行业资本支出分析	262
8.4 集成电路封装行业投资建议	263
8.4.1 集成电路封装行业投资机会分析	263
8.4.2 集成电路封装行业投资风险分析	264
8.4.3 集成电路封装行业投资建议	267
(1) 投资区域建议	267
(2) 投资产品建议	267
(3) 技术升级建议	268

图表目录（部分）：

图表1：集成电路封装行业产品分类 15

图表2：我国集成电路封装企业地区分布（单位：%） 16

图表3：2018年10月江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元） 17

图表4：2011年以来集成电路封装在集成电路产业中占比变化（单位：%） 17

- 图表5：集成电路封装行业主要政策分析 18
- 图表6：2018年10月发达经济体增长情况（单位：%） 19
- 图表7：2018年10月主要新兴经济体增长情况（单位：%） 20
- 图表8：2018年10月主要国家1季度经济增长速度（单位：%） 21
- 图表9：2018年10月世界银行和IMF对于世界主要经济体的预测（单位：%） 22
- 图表10：2013-2018年10月中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 23
- 图表11：2014年以来中国GDP增速与集成电路封装行业产值增速对比图（单位：%） 23
- 图表12：2013-2018年10月我国城镇居民人均可支配收入及其变化趋势（单位：元，%） 24
- 图表13：2013-2018年10月我国农村居民纯收入及其变化趋势（单位：元，%） 24
- 图表14：封装技术的演进 25
- 图表15：各种集成电路封装形式应用领域 26
- 图表16：集成电路封装工艺流程 26
- 图表17：集成电路产业链示意图 29
- 图表18：2018年10月中国集成电路产业发展情况（单位：亿元，亿块，亿美元，%） 30
- 图表19：2018年10月我国集成电路产业结构（单位：%） 31
- 图表20：中国集成电路产业长三角地区分布概况 32
- 图表21：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析 34
- 图表22：2013-2018年10月我国集成电路设计市场销售额走势（单位：亿元） 37
- 图表23：集成电路设计业新发展策略 39
- 图表24：集成电路制造业发展主要特点分析 40
- 图表25：2013-2018年10月中国集成电路制造业规模分析（单位：家，人，万元） 41
- 图表26：2013-2018年10月中国集成电路制造业盈利能力分析（单位：%） 42
- 图表27：2013-2018年10月中国集成电路制造业运营能力分析（单位：次） 42
- 图表28：2013-2018年10月中国集成电路制造业偿债能力分析（单位：% ，倍） 43
- 图表29：2013-2018年10月中国集成电路制造业发展能力分析（单位：%） 43
- 图表30：2013-2018年10月中国集成电路制造业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 44

图表详见正文.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yiqiyibiao/378040378040.html>